

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #1243

任务 # 1220 (完结): 无锡百发 内阻管理模块定制3套首样

功能 # 1231 (完结): 3. 管理模块PCB改进

### 2. 样板焊接与测试

2017-10-29 15:24 - 韦士飞

|       |      |         |            |
|-------|------|---------|------------|
| 状态:   | 完结   | 开始日期:   | 2017-11-02 |
| 优先级:  | 普通   | 计划完成日期: | 2017-11-06 |
| 指派给:  | 盘 贵星 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |      | 耗时:     | 0.00 小时    |

#### 描述

新打的PCB样板焊接，先焊接两片测试。在硬件测试没有问题之后，再焊剩下的几片。

#### 历史记录

#1 - 2017-11-01 17:27 - 韦士飞

- 状态从 *新建* 变更为 *已发货*

- % 完成从 0 变更为 30

样板已焊接了一块。测试时与LCD屏连接的IIC接口IO无法输出高电平。经查阅数据手册发现IIC接口IO为真开漏输出，其IO属性为高阻态。需外接上拉电阻之后才能做为有效IO接口，以驱动外设。

#2 - 2017-11-01 18:08 - 盘 贵星

2017-11-11、完成焊接一个PCB样板，软件测试后没问题继续焊接剩余4片。

#3 - 2017-11-09 09:19 - 盘 贵星

- % 完成从 30 变更为 70

2017-11-9 1、已经完成5套样机焊接，就差排针采购，今天到货后补齐焊接，即可交付技术部测试。

#4 - 2017-11-12 10:36 - 盘 贵星

- % 完成从 70 变更为 100

2017-11-12 已完成5套样板焊接，测试功能正常。

#5 - 2017-11-12 10:36 - 盘 贵星

- 状态从 *已发货* 变更为 *调试中*

#6 - 2017-12-04 10:17 - om 经理1

- 状态从 *调试中* 变更为 *完结*